L10-FePt 作製プロセスにおける実効的組成比変動現象の

起源および抑制検討

小松田恭祐¹, 塚本新²

(1日本大学大学院理工学研究科,2日本大学理工学部)

Investigation of origin and suppression to variation of composition ratio in L10- FePt fabrication process

K. Komatsuda¹, A. Tsukamoto²

(¹Graduate School of Nihon Univ, ²College of Science and Technology, Nihon Univ.)

はじめに 超高密度磁気記録媒体の作製を目的として、Fe/Pt 二層膜に対して急速昇温熱処理(RTA: Rapid Thermal Annealing)および急速降温熱処理(RCP: Rapid Cooling Process)を施すことで, L10規則合金化した FePt 孤立微粒子群が生成可能であることを報告している¹⁾. そのプロセス途中で L10- FePt 以外の, Fe を含む相 が出現することが確認されているが、これらの詳細な生成段階は不明確であった.本研究では、主に磁気特

性の観点から L10- FePt 以外の異種 Fe 系相の存在を明らかにする.

実験方法

①[ナノ微粒子形成の基板依存性] (i) 熱酸化 Si 基板および (ii) 熱 酸化 Si 基板上に SiN(20nm)を積層した基板の各々に対して、初期積 層厚 1.88 nm 一定, 種々の組成比 Fe_xPt_{100-x} (x = 50~63.7 at.%)で Fe/ Pt 二層膜を成膜した. これらの試料に対して到達真空度<1.0×10-3 Paの雰囲気下で赤外線ランプ光照射による昇温速度約 180 ℃/sec., 目標最高到達温度 700 ℃の急速昇温を行い、その後、窒素導入によ り降温速度約-120 ℃/sec.で急速降温処理を行った.

②[3 条件での Fe 薄膜形成] (a) 熱酸化 Si 基板上に sub./ Fe(trenm)/ SiN(3 nm) (tre = 1.88, 3.26, 5.26)の膜構成で成膜した. (b) 熱酸化 Si 基板上に sub./ SiN(20 nm)/ Fe(1.88 nm)/ SiN(3 nm)の膜構成で成膜し た. (c) 熱酸化 Si 基板上に真空下にてプラズマアッシングを施し, 真空下で連続して (a) と同条件で成膜した.

Fe, Ptの成膜はDCマグネトロンスパッタ法, SiNの成膜はRF マグネトロンスパッタ法にて行った. 作製した試料の磁気特性評価 には超伝導量子干渉素子式振動試料型磁力計(SQUID-VSM)を用 い,磁化曲線測定を行った.

実験結果 Fig.1 に, 基板(i) (ii)上で作製した FePt ナノ微粒子試料(粒 形~16 nm)の磁気特性から算出した,飽和磁化 Ms,保持力 HcのFe 組成比依存性を示す.最表面が SiOx である基板(i)に対し SiN である 基板(ii)を用いた場合,組成比 x= 50 at.%における Ms, Hc が共に増 大, Ms, Hcが最大となる Fe 組成比が 50:50 側にシフトする,等の 効果が確認できる. この結果は、高い保磁力を示す成膜組成比がス トイキオメトリより Fe 過多側となる原因が、成膜段階での SiOx/Fe Fig.2 Magnetic moment of interface modified

界面における Fe 化合物生成にあるとの仮定を支持するものであ



Fig.1 (1) Saturation magnetization $M_{\rm S}$ and (2) Coercivity H_C of FePt sample (i) (ii)



Fe thin film samples (a) - (c)

る.また,詳細検討を行った Fig.2 の結果より,(a) SiOx 上の Fe 薄膜では一定量の Fe 磁気モーメント量の消 失が見られるが、(b) SiN 上の Fe 薄膜では、その現象が大幅に改善した. さらに (c) の結果から、消失の要 因が界面原子種のみならず、大気暴露による効果が主要な要因であることが明らかとなった.

以上より基板最表面の窒化 Si 化による有効性,プラズマアッシングによる低減効果の可能性が示された.

謝辞 本研究の一部は、情報ストレージ研究推進機構の助成により行った.

参考文献

- 1) Y. Itoh, T. Aoyagi, A. Tsukamoto, K. Nakagawa, A. Itoh and T. Katayama: Jpn. J. Appl. Phys., 43, 12, 8040(2004)
- 2) Y. Utsushikawa, K. Niizuma: Journal of Alloys and Compounds 222 (1995) 188-192